

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2025-056

芯联集成电路制造股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币6.83亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、可转让大额存单、通知存款、收益权凭证等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在授权额度范围内，董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确的同意意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月13日出具的《关于同意绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕548号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股169,200.00万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币5.69元，募集资金总额为人民币962,748.00万元（行使超额配售选择权之前），扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币937,276.55万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月5日出具了《验资报告》（天职业字[2023]33264号），验证募集资金已全部到位。

2023年6月8日，保荐人海通证券股份有限公司（主承销商）全额行使超额配

售选择权，公司在初始发行169,200.00万股普通股的基础上额外发行25,380.00万股普通股，由此增加的募集资金总额为144,412.20万元，扣除发行费用（不含增值税）3,347.05万元，超额配售募集资金净额为141,065.15万元。保荐机构（主承销商）已于2023年6月9日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金扣除承销费用（不含增值税）后划付给公司。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于2023年6月9日出具了《验资报告》（天职业字[2023]35399号）。

全额行使超额配售选择权后，公司在初始发行169,200.00万股普通股的基础上额外发行25,380.00万股普通股，故本次发行最终募集资金总额为1,107,160.20万元。扣除发行费用28,818.50万元，募集资金净额为1,078,341.70万元。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2023-019）以及《芯联集成电路制造股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-009）。

二、募集资金投资项目情况

根据《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资计划，公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议根据实际募集资金净额对公司募投项目使用募集资金投资金额进行的调整，以及公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议、第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议基于新增募投项目，对公司募投项目使用募集资金投资金额进行的调整，调整后的募集资金使用计划如下：

单位：亿元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金总额
1	MEMS 和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目	65.64	-
2	二期晶圆制造项目	110.00	16.60
3	中芯绍兴三期 12 英寸特色工艺晶圆制造中试线项目	42.00	22.10
4	三期 12 英寸集成电路数模混合芯片制造项目	180.00	27.90
5	补充流动资金	43.40	41.23
合计		441.04	107.83

根据《芯联集成电路制造股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，扣除发行费用后募集资金净额为 1,078,341.70 万元，截止 2025 年 6 月 30 日，公司累计投入募投项目的募集资金总额 983,809.72 万元，累计投入进度为 91.23%，尚未到期的结构性存款金额为 77,000.00 万元，募集资金专户余额为 21,558.50 万元。随着银行 LPR 逐渐降低，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《芯联集成电路制造股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

（二）额度及期限

公司拟使用额度不超过 6.83 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）现金管理品种

为控制募集资金使用风险，公司使用暂时闲置的募集资金通过购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、可转让大额存单、通知存款、收益权凭证等）进行现金管理。

公司不会将暂时闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种、无担保债券为主要投资标的理财产品。上述投资产品不得质押。

（四）决议有效期限

自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《芯联集成电路制造股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

（七）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

四、对公司经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的收益，为公司和股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、可转让大额存单、通知存款、收益权凭证等）。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行，以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、独立董事有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司必须严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《芯联集成电路制造股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露的义务。

六、公司履行的审批程序

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 6.83 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、可转让大额存单、通知存款、收益权凭证等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在授权额度范围内，董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

上述事项已获得董事会的审批，保荐机构发表了明确的同意意见。

七、专项意见说明

（一）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高公司募集资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日